

Fill-PT 800导热凝胶垫片

产品描述



导热凝胶垫片Fill-PT800其导热系数为 $8.0\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，是由导热凝胶压制而成的片材，特殊的结构设计确保产品在极低的压缩应力下产生极高的压缩形变，在填充不同尺寸的间隙的同时，产生非常微弱甚至可以忽略的残余应力，最大程度地减小对精密电子器件的冲击，适用于需要多形变公差的应用。产品有玻纤对表面进行保护，保持了良好的界面润湿特性，最大化的消除界面热阻，同时又具备良好的操作性能，便于施工。

产品特点

- ◆ 高导热系数， $8\text{W/m}\cdot\text{K}$
- ◆ 超柔软，低压缩应力产生高压缩形变
- ◆ 微弱的残余应力有效保护敏感器件
- ◆ 表面自粘性
- ◆ 出色的润湿性及贴合性
- ◆ 单玻纤增强，提高操作性

典型应用

- ◆ 5G通信基站、无线通信设备
- ◆ 大数据存储器、网络服务器
- ◆ 大功率电源模块及IGBT
- ◆ 汽车电子OBC、逆变器
- ◆ LCD、PDP和激光电视显示器
- ◆ 硬盘驱动器及固态硬盘存储设备

技术参数

性能参数	Fill-PT 800	测试方法
基本特性		
结构	无/单玻纤增强	N/A
颜色	淡灰色	目视
厚度范围 (mm)	0.5 ~ 5.00	N/A
工作温度($^{\circ}\text{C}$)	-40 ~ 150	泰吉诺实验室
密度 (g/cm^3)	3.5	ASTM D792
硬度(Shore 00)	10	ASTM D2240
挥发物 TML (%)	0.22	ASTM E595
挥发物 CVCN (%)	0.05	ASTM E595
$\Sigma\text{D3-D10}$ (硅氧烷含量PPM)	<100	GC-MS
导热性能		
导热系数 ($\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$)	8.0	ASTM D5470
热阻 ($^{\circ}\text{C}\cdot\text{in}^2/\text{W}$) (1mm@10psi)	0.17	ASTM D5470
电学性能		
介电常数@ 1 MHz	8.3	ASTM D150
体积电阻率($\text{ohm}\cdot\text{cm}$)	3.0×10^{15}	ASTM D257
阻燃等级		
阻燃等级	V-0	UL 94

注：本资料中数据皆为测试典型值，结果仅供参考，不可作为产品性能指标使用

注意事项

- ◆ 切勿食用
- ◆ 避开儿童可触及的地方保管
- ◆ 产品放置须远离火源
- ◆ 请确认使用的正确性之后再使用
- ◆ 注意不要让产品表面沾上异物和灰尘

保存及寿命

- ◆ 产品需在 $0\sim 35^{\circ}\text{C}$ ， $\leq 65\%$ 相对湿度环境下保存
- ◆ 保质期自包装之日起12个月

订购信息

- ◆ 厚度标称值 $\pm 10\%$ ，厚度可以根据客户要求定制。订购前请详询可用厚度

泰吉诺材料科技

www.techinnotech.com

苏州市常熟高新技术产业开发区东南大道68号3幢
电话：0512-52691088 传真：0512-52696157

